



豊田バンモップス株式会社

NEW!!

ビトリファイドダイヤモンドホイール

Vitrified bonded Diamond Grinding Wheel

陶瓷金刚石砂轮

ウエハ加工用

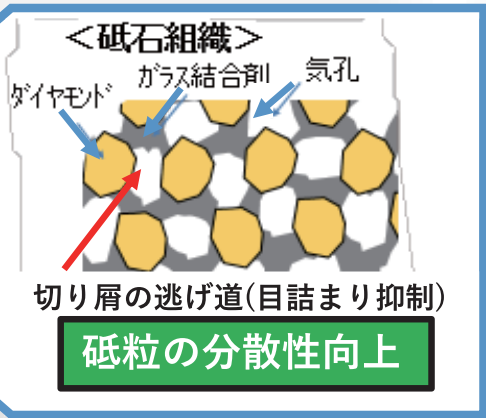
Processing of wafer

晶圆加工用

自動車分野で**35年**培った
結合剤技術で開発

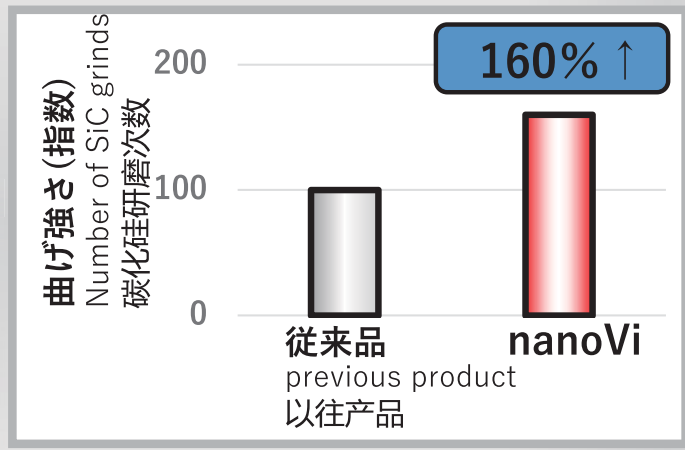
Developed with binder technology cultivated for 35 years in the automobile field

以在汽车领域深耕35年的粘合剂技术开发而成



新製品
New Products
新产品

"nanoVi"



TOYODA VAN MOPPES LTD.

当社は「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション (TPEC) に参加し協業で本開発を実施しました



切れ味良好 かつ 長寿命！！

Good Sharpness & Long life

锐度好，寿命长

加工評価

Processing evaluation

加工评价

6インチ SiC ウエハ

6inch SiC wafer

6inch SiC 晶圆

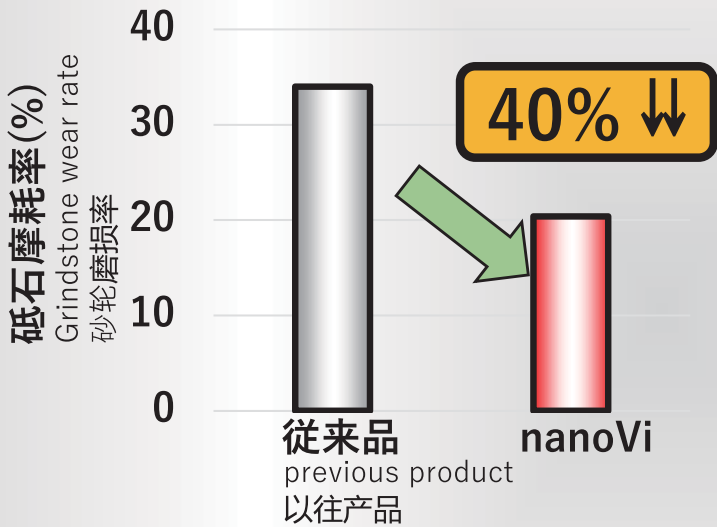


図. 砥石摩耗率比較

Fig. Grindstone wear rate comparison

图. 砂轮磨损率对比

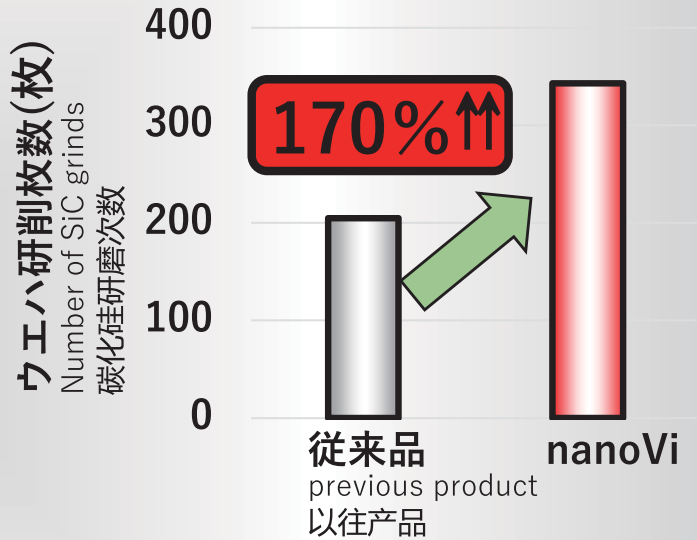


図. ホイール1枚当たりの SiCウエハ研削枚数

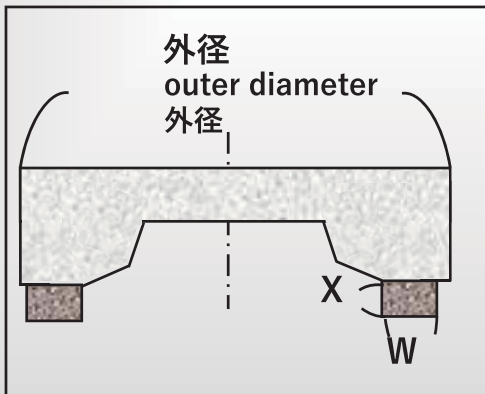
Fig. The number of grinding pieces of SiC wafer grinding stone 1 piece

图. 每轮磨削的 SiC 晶圆数量

製品模式図

product schematic diagram

产品模式图



標準寸法

standard dimensions

标准尺寸

外径 (mm) Outer diameter 外径	X (mm)	W (mm)
Φ150	3, 7*1	3
Φ180		
Φ200		
Φ250		
Φ300		

*1 標準寸法以外も対応いたします。

Other than standard dimensions are also available
我们还提供非标准尺寸



豊田バンモップス株式会社
TOYODA VAN MOPPES LTD.

本社・工場 〒444-3594

愛知県岡崎市 TEL(0564)48-5311(代表)、5314(営業部)

営業拠点 東京・浜松・岡崎・大阪・広島・福岡

Head Office/Plant Okazaki-city Aichi, Japan

Phone +81-(0)564-48-5317(Sales)

Sales base Tokyo・Hamamatsu・Okazaki・Osaka・Hiroshima・Fukuoka

总公司/工厂 日本爱知县冈崎市

电话 +81-(0)564-48-5317(営業部)



詳しくは、
当社HPへ！

<https://www.tvmk.co.jp/>